



RE931

- Epoxydglashartgewebe FR4 1,50 mm
- Zweiseitig 35 µm Cu
- Durchkontaktiert (PTH)
- Oberfläche chem. Ni/Au mit Lötstopplack beschichtet
- Adaptionplatine für 7 verschiedene SSOP's
- Pitch: 0,65 mm & 0,635 mm
- Lochdurchmesser 1,00 mm
- vorgertzte Sollbruchstellen zum Trennen einzelner Module von der Platine
- Größe 61,40 x 81,70 mm

Modul-Nr.	Pitch	mil	Pin	Größe (mm)
RE931-01	0,650 mm	25,6	14	5,300 (208 mil)
RE931-02	0,650 mm	25,6	16	5,300 (208 mil)
RE931-03	0,650 mm	25,6	20	5,300 (208 mil)
RE931-04	0,650 mm	25,6	24	5,300 (208 mil)
RE931-05	0,650 mm	25,6	28	5,300 (208 mil)
RE931-06	0,635 mm	25,0	48	7,500 (295 mil)
RE931-07	0,635 mm	25,0	56	7,500 (295 mil)